

SOD-323FL封装肖特基

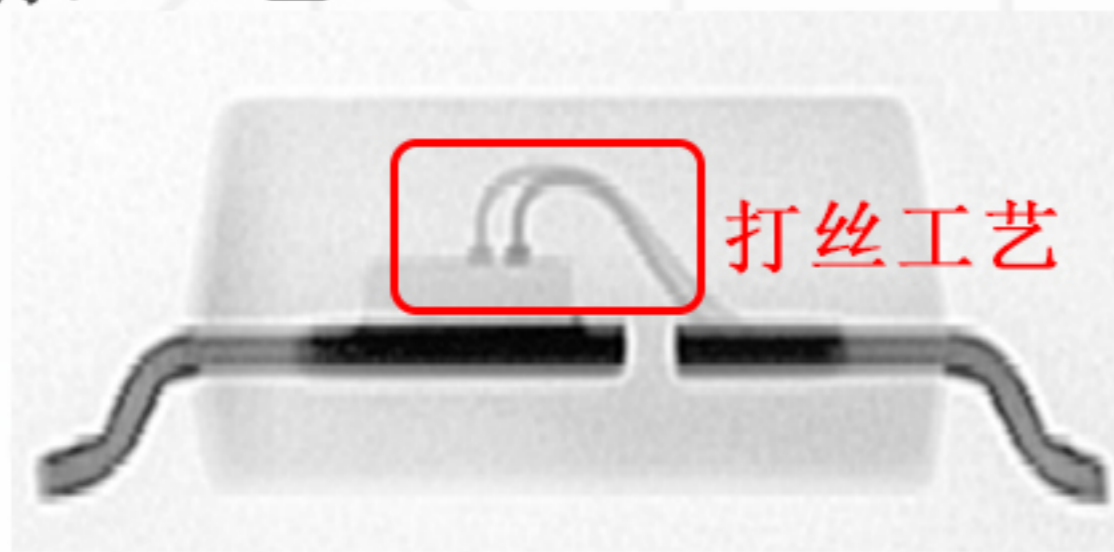
产品介绍

1. SOD-323FL封装体积小，可应用于小型化电路；
2. SOD-323FL产品采用环保物料，符合RoHS标准；
3. SOD-323FL肖特基产品正向压降低、浪涌能力强、功率损耗低、效率高；
4. SOD-323FL肖特基产品广泛应用于安防、通信、TV等电路。

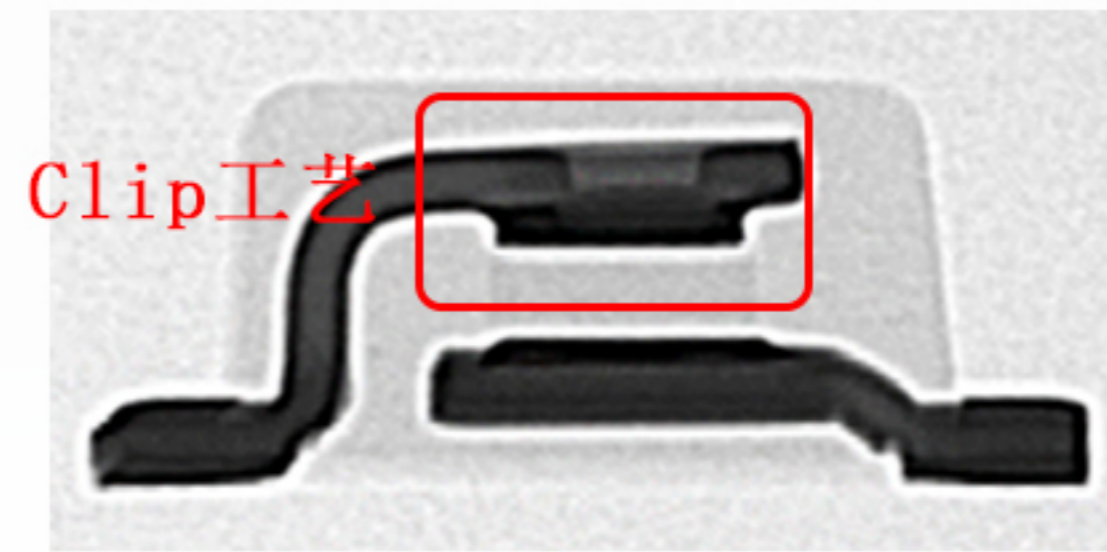


产品特点

1. 正向浪涌能力强：SOD-323FL封装采用Clip工艺，可承受大电流冲击，正向浪涌能力强，远优于SOD-323的打丝工艺。

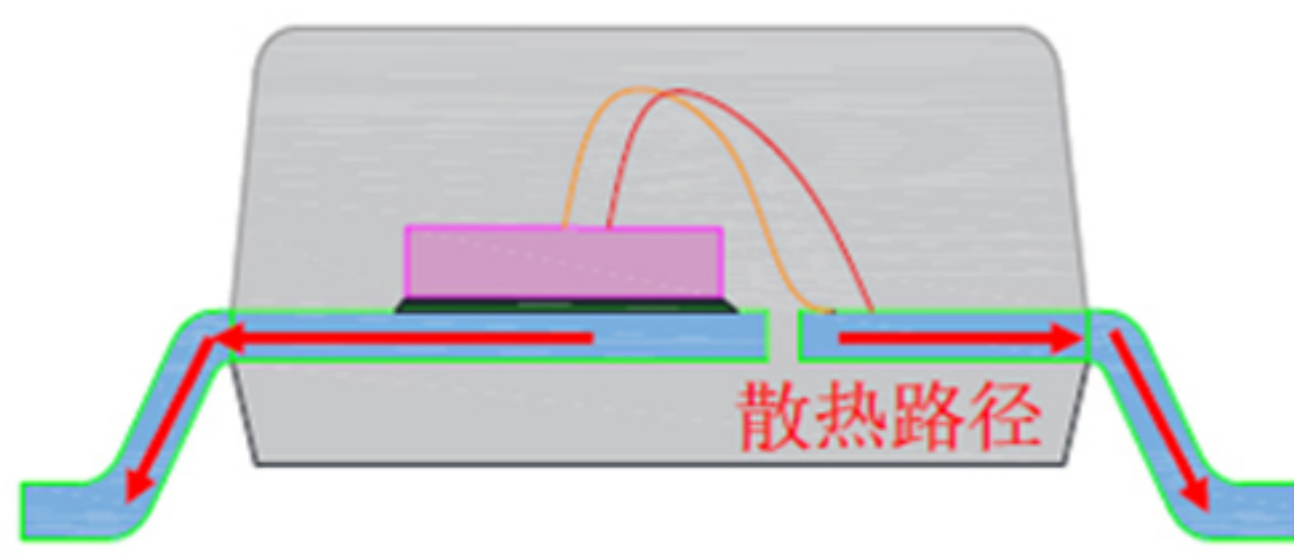


SOD-323封装打丝工艺

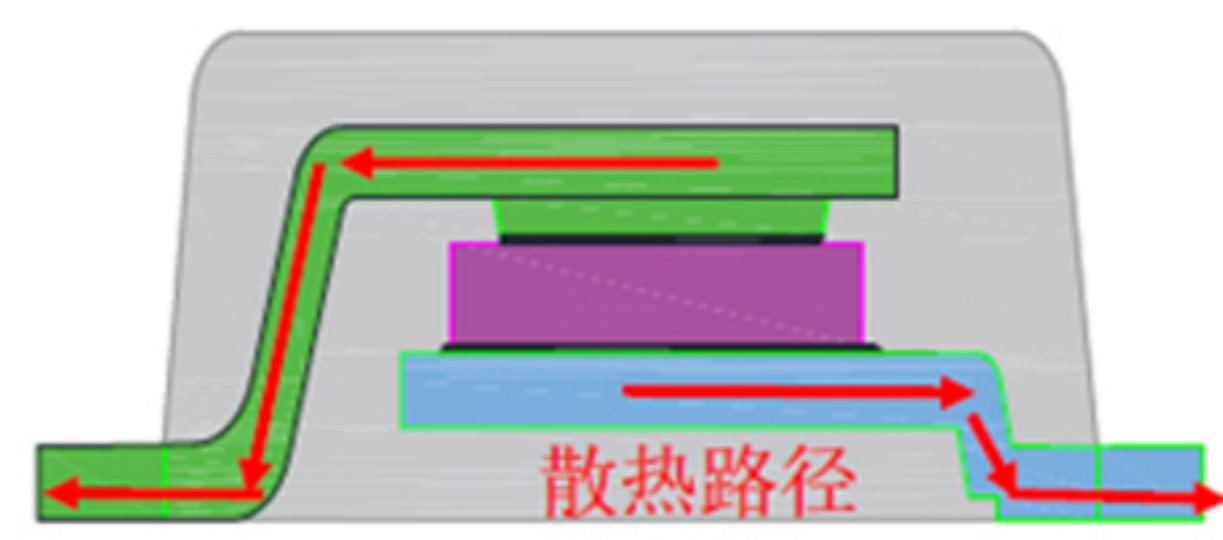


SOD-323FL封装Clip工艺

2. 散热性能强：SOD-323FL封装采用两片式框架结构，两片式框架散热渠道，相对SOD-323封装打丝产品散热效果更好，且散热路径短，对应热阻值低，高温性能好。

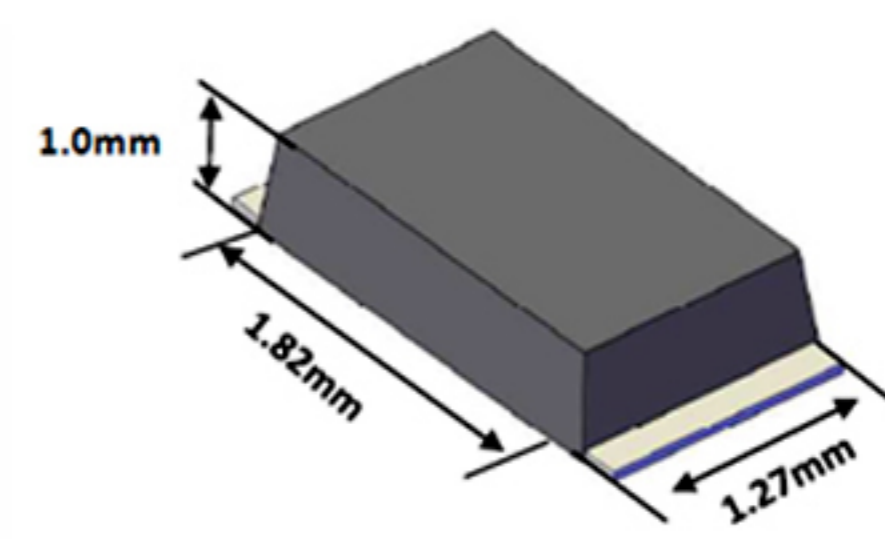
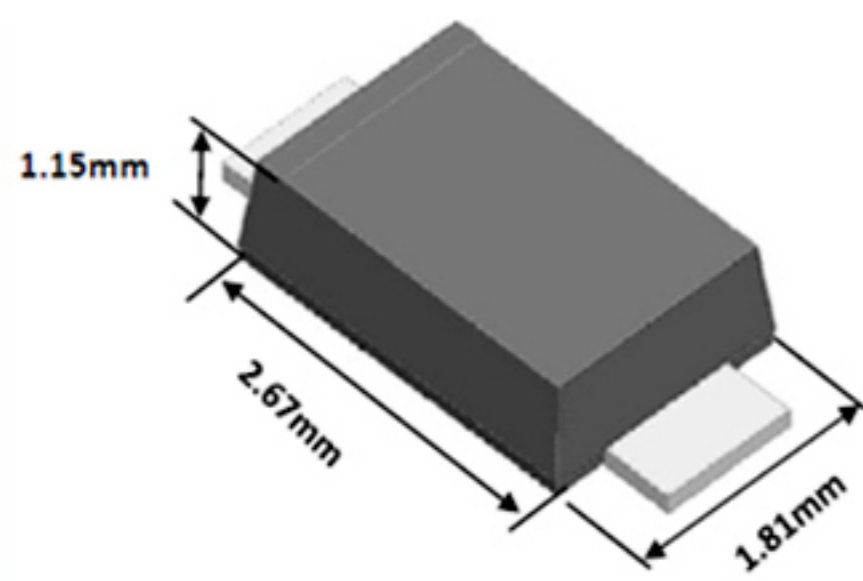


SOD-323封装



SOD-323FL封装

3. 封装体积小：相对同为Clip封装工艺的SOD-123FL产品，SOD-323FL封装体积更小，适用于小型化、集成化电路。

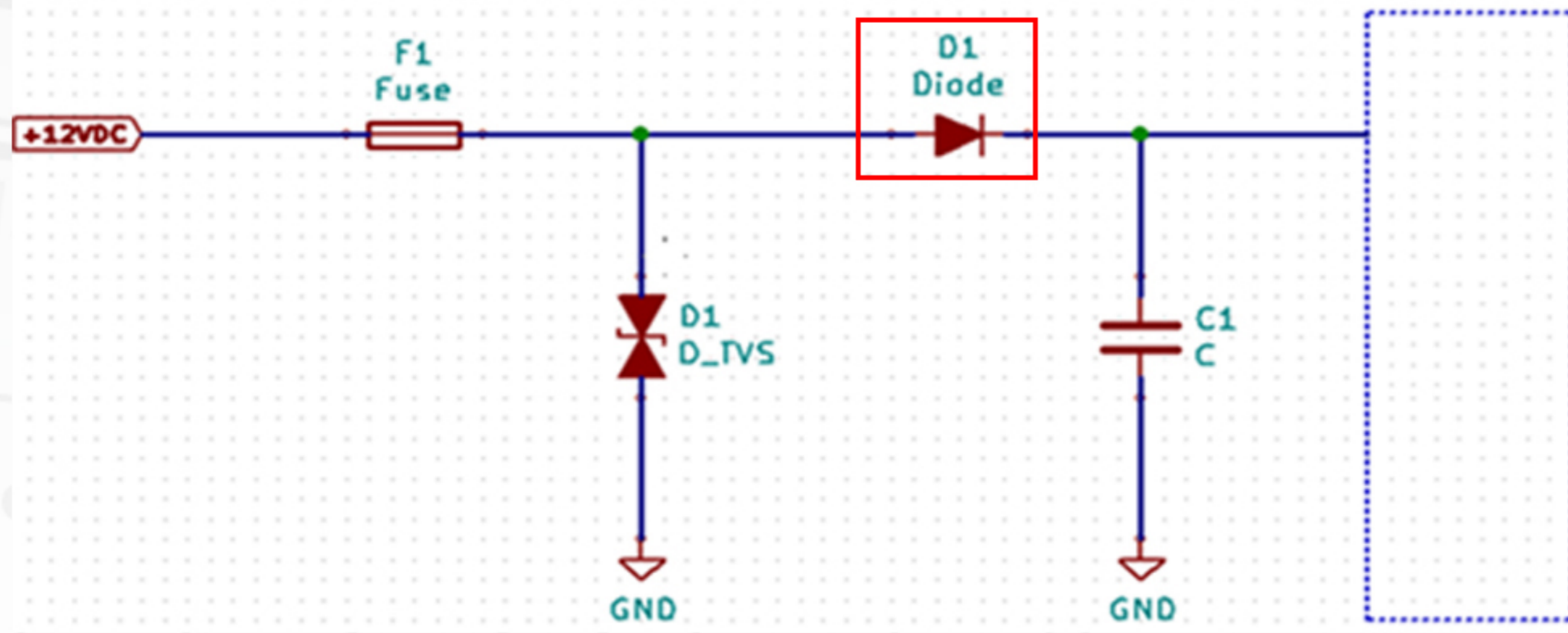


电性参数

最大反向峰值电压 Max.Reverse Voltage V_{RM} (V)	最大正向电流 Max.Aver. Rect.Current I_o (A)	工作结温 Operation Temp.Range T_j (°C)	封装 Package
20-40	1.0	-55 ~ +125	SOD-323FL
50-200	1.0	-55 ~ +150	SOD-323FL
20-40	2.0	-55 ~ +125	SOD-323FL
50-200	2.0	-55 ~ +150	SOD-323FL

应用电路

防反整流电路



应用领域

